

ELMOS Semiconductor AG
Dortmund

Jahresabschluss und Lagebericht
31. Dezember 2008

Bestätigungsvermerk

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der ELMOS Semiconductor AG, Dortmund, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Dortmund, 3. März 2009

Ernst & Young AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Englisch
Wirtschaftsprüfer

Krebs
Wirtschaftsprüfer

ELMOS Semiconductor AG, Dortmund
Gewinn- und Verlustrechnung für 2008

	EUR	EUR	2007 TEUR
1. Umsatzerlöse	159.439.098,05		158.352
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	3.488.784,09		4.396
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	184.481,49		197
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>4.976.960,49</u>		<u>3.898</u>
		168.089.324,12	<u>166.843</u>
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-20.100.795,90		-21.212
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-49.399.584,31		-46.786
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-33.198.563,90		-31.416
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung EUR 135.514,64 (Vj. TEUR 127)	-5.827.645,54		-5.627
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-13.848.355,71		-13.009
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-50.738.471,58</u>		<u>-53.047</u>
		-173.113.416,94	<u>-171.097</u>
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen EUR 1.848.321,08 (Vj. TEUR 1.928)	1.848.321,08		1.928
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen EUR 4.154.090,00 (Vj. TEUR 38)	5.622.986,90		769
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen EUR 1.364.512,00 (Vj. TEUR 0)	1.364.512,00		0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 2.349.293,49 (Vj. TEUR 1.362)	-5.039.415,98		-3.480
		<u>3.796.404,00</u>	<u>-783</u>
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.227.688,82	<u>-5.037</u>
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.355.107,54		-24
15. Sonstige Steuern	<u>-325.166,09</u>		<u>-255</u>
		-1.680.273,63	<u>-279</u>
16. Jahresfehlbetrag		-2.907.962,45	-5.316
17. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		<u>39.621.311,85</u>	<u>44.937</u>
18. Bilanzgewinn		<u>36.713.349,40</u>	<u>39.621</u>

ELMOS Semiconductor AG, Dortmund

Anhang für 2008

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des AktG und der Satzung aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene **immaterielle Vermögensgegenstände** sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen (3 - 10 Jahre, lineare Methode) vermindert.

Das **Sachanlagevermögen** ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die **Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens** werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer auf der Grundlage steuerlich anerkannter Höchstsätze abgeschrieben. Soweit steuerlich zulässig, wird für bewegliche Anlagegüter die degressive Abschreibungsmethode angewandt. Zur linearen Methode wird in dem Jahr, für welches die lineare Methode erstmals zu höheren Jahresabschreibungsbeträgen führt, übergegangen. Die übrigen Anlagegüter werden linear abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von EUR 150,00 (bis zum 31. Dezember 2007 EUR 410,00), sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt. Für Anlagegüter mit einem Netto-Einzelwert von mehr als EUR 150,00 bis EUR 1.000,00, die nach dem 31. Dezember 2007 angeschafft worden sind, wurde der jährlich steuerlich zu bildende Sammelposten aus Vereinfachungsgründen in die Handelsbilanz übernommen. Von den jährlichen Sammelposten, deren Höhe insgesamt von untergeordneter Bedeutung ist, werden entsprechend den steuerlichen Vorschriften pauschalierend jeweils 20 % p. a. im Jahr, für dessen Zugänge er gebildet wurde, und den 4 darauf folgenden Jahren abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden im Übrigen zeitanteilig vorgenommen.

Bei den **Finanzanlagen** werden die Anteilsrechte und Wertpapiere zu Anschaffungskosten bzw. niedrigeren beizulegenden Werten und die Ausleihungen grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Ansprüche aus Rückdeckungsversicherung werden zum Aktivwert angesetzt.

Die **Vorräte** werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. zu den niedrigeren Tageswerten angesetzt. Die Bestände an **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen** sind zu durchschnittlichen Einstandspreisen oder zu niedrigeren Tagespreisen am Bilanzstichtag aktiviert.

Für ein Freihand- sowie ein Ersatzteillager wurden **Festwerte** gebildet.

Die **unfertigen und fertigen Erzeugnisse** sind auf der Basis von Einzelkalkulationen, die auf der aktuellen Betriebsabrechnung beruhen, zu Herstellungskosten bewertet, wobei neben den direkt zurechenbaren Materialeinzelkosten, Fertigungslöhnen und Sondereinzelkosten auch Fertigungs- und Materialgemeinkosten sowie Abschreibungen entsprechend dem steuerrechtlichen Mindestumfang berücksichtigt werden. In allen Fällen wurde verlustfrei bewertet, d. h. es wurden von den voraussichtlichen Verkaufspreisen Abschläge für noch anfallende Kosten vorgenommen.

Alle erkennbaren Risiken im **Vorratsvermögen**, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt.

Die **Rückstellungen für Pensionen und Vorruhestandsverpflichtungen** werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt. Den Teilwerten gemäß § 6a EStG liegt ein Rechnungszinsfuß von 6 % zugrunde.

Die **Steuerrückstellungen** und die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Zuschüsse auf Entwicklungsleistungen werden als erhaltene Anzahlungen ausgewiesen.

Fremdwährungen wurden zu Umrechnungskursen am Tage ihrer Entstehung oder zu niedrigeren bzw. höheren Stichtagskursen bilanziert.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt.

Angaben zum Anteilsbesitz

	Währung	Beteiligungen %	Eigenkapital in TEUR/LW	Ergebnis in Tausend
Inland				
Advanced Appliances Chips GmbH, Riedstadt	EUR	33,33	239	65 ¹
attoSENSOR GmbH, Penzberg	EUR	45,00	61	1 ¹
ELMOS Central IT Services GmbH & Co. KG, Dortmund	EUR	100,00	173	227 ²
ELMOS Facility Management GmbH & Co. KG, Dortmund	EUR	100,00	92	602 ²
ELMOS Semiconductor Süd GmbH, München	EUR	100,00	176	4 ²
Epigone Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG, Mainz	EUR	45,00	25	-2 ¹
GED Gärtner Electronic Design GmbH, Frankfurt/Oder	EUR	73,90	1.261	259
Gesellschaft für Halbleiterprüftechnik mbH, Dortmund	EUR	100,00	118	5 ³
IndustrieAlpine Bauträger GmbH, München	EUR	51,00	-998	-132
Mechaless Systems GmbH, Karlsruhe	EUR	51,00	-503	-235
ELMOS Industries GmbH, Hanau	EUR	49,00	-1.028	-272
DMOS Dresden MOS Design GmbH, Dresden	EUR	20,00	355	-116

¹ Die vorgelegten Zahlen beruhen auf vorläufigen, ungeprüften Abschlüssen zum 31. Dezember 2008.

² Es handelt sich um mittelbaren Anteilsbesitz der ELMOS Semiconductor AG, Dortmund.

³ Die vorgelegten Zahlen beruhen auf dem Abschluss zum 31. Dezember 2007.

	Währung	Beteiligungen %	Eigenkapital in TEUR/LW	Ergebnis in Tausend
Ausland				
Elmos Services B.V., Nijmegen (NL)	EUR	100,00	80.389	9.852
Elmos Advanced Packaging B.V., Nijmegen (NL)	EUR	100,00	-7.168	-5.992 ¹
ELMOS Design Services B.V., Nijmegen (NL)	EUR	100,00	1.358	2.688 ¹
ELMOS Quality Services B.V., Nijmegen (NL)	EUR	100,00	434	337 ¹
European Semiconductor Assembly (Eurasem) B.V., Nijmegen (NL)	EUR	100,00	9.545	0 ¹
Micro Systems on Silicon (MOS) Limited, Pretoria (Südafrika)	ZAR	67,60	-2.086	-1.123 ¹
ELMOS France S.A.S., Levallois Perret (F)	EUR	100,00	2.497	1.194
Elmos USA Inc., Farmington Hills (USA)	USD	100,00	--	-- ²
ELMOS California Inc., Milpitas (USA)	USD	100,00	-345	-49 ¹
ELMOS N.A. Inc., Farmington Hills (USA)	USD	100,00	519	3.524 ¹
Silicon Microstructures Inc., Milpitas (USA)	USD	100,00	-1.241	2.648 ¹

Vorräte

Im Geschäftsjahr wurden außerplanmäßige Abschreibungen auf Vorratsvermögen in Höhe von TEUR 713 vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben bis auf einen Betrag von TEUR 98 (Vj. TEUR 97) eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind aktivierte Forderungen auf Erstattung von verauslagten Entwicklungskosten in Höhe von TEUR 480 (Vj. TEUR 233) enthalten.

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Hierin ist ein Disagio in Höhe von TEUR 74 enthalten.

¹ Es handelt sich um mittelbaren Anteilsbesitz der ELMOS Semiconductor AG, Dortmund.

² Es liegt bislang kein Jahresabschluss der Gesellschaft vor.

Eigenkapital

Das in der Bilanz zum 31. Dezember 2008 aus 19.414.205 auf den Inhaber lautenden, nennwertlosen Stückaktien bestehende Grundkapital in Höhe von EUR 19.414.205,00 ist voll eingezahlt.

Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital bis zum 18. Mai 2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu EUR 9.650.000,00 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 9.650.000 Stück neuer, auf den Inhaber lautender Aktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (**Genehmigtes Kapital I**).

Das Grundkapital ist um EUR 885.795,00, eingeteilt in 885.795 nennwertlose Stückaktien, die auf den Inhaber lauten, mit einem auf die einzelne Aktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00, bedingt erhöht (**Bedingtes Kapital I**). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Führungsorgane und an Mitarbeiter verbundener Unternehmen. Sie wird nur insoweit durchgeführt, wie im Rahmen des Aktienoptionsprogramms der Gesellschaft nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 22. September 1999 Optionsrechte ausgegeben werden und die Inhaber dieser Optionsrechte diese ausüben. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Optionsrechten entstehen, am Gewinn teil.

Das Grundkapital ist um maximal bis zu EUR 5.000.000,00, eingeteilt in bis zu 5.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (**Bedingtes Kapital II**). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Optionsscheinen oder Wandlungsrechten bis zum 9. Mai 2012 durch die Gesellschaft oder durch eine unmittelbare oder mittelbare inländische oder ausländische 100-prozentige Beteiligungsgesellschaft der Gesellschaft aus gemäß der Beschlussfassung der Hauptversammlung vom 10. Mai 2007 begebenen Options- oder Wandelschuldverschreibungen Gebrauch machen oder wie die zur Wandlung verpflichteten Inhaber der von der Gesellschaft oder deren unmittelbaren oder mittelbaren inländischen oder ausländischen 100-prozentigen Beteiligungsgesellschaften bis zum 9. Mai 2012 auszugebenden Wandelschuldverschreibungen ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Options- bzw. Wandlungsrechten oder durch Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 930.000,00 eingeteilt in 930.000 nennwertlose Stückaktien, die auf den Inhaber lauten, mit einem auf die einzelne Aktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von 1,00 Euro, bedingt erhöht (**Bedingtes Kapital III**). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Führungsorgane und an Mitarbeiter verbundener Unternehmen („Aktienoptionsplan 2004“). Sie wird nur insoweit durchgeführt, wie im Rahmen des Aktienoptionsplans 2004 der Gesellschaft nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 27. April 2004 Optionsrechte ausgegeben werden und die Inhaber dieser Optionsrechte diese wirksam ausüben. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Optionsrechten entstehen, am Gewinn teil.

Es bestehen Bezugsrechte gemäß § 192 Abs. 2 Nr. 3 AktG aus einem Aktienoptionsprogramm für Vorstandsmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter zum Erwerb von 409.916 Aktien. Jedes Bezugsrecht berechtigt zum Bezug einer Stückaktie ohne Nennwert mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00.

Gratisaktien-Programm (Stock Awards)

Im Jahr 2007 wurde erstmalig ein Gratisaktien-Programm (Stock Awards) aufgelegt. Die Stock Awards wurden an besonders verdiente Mitarbeiter, Führungskräfte und Mitglieder des Vorstandes in Anerkennung für die im Vorjahr erbrachte Leistung vergeben. Die Gewährung dieser Awards soll zum einen die Verbundenheit von ELMOS mit ihren Leistungsträgern zeigen und zum anderen als Motivation für das Engagement und die Leistungsbereitschaft verstanden werden. Auch in 2008 wurde ein Stock Awards Programm begeben.

Das Stock Awards Programm 2008 umfasst 50.000 Aktien und entspricht 0,26 % des Grundkapitals. Diese Aktien wurden zuvor an der Börse im Rahmen der Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien zurück erworben. Für die Stock Awards gilt eine Haltefrist von 2 Jahren; davon ausgenommen ist ein Verkauf von Aktien in der erforderlichen Anzahl, sodass die Steuern, die auf den geldwerten Vorteil der Mitarbeiter, Führungskräfte und Mitglieder des Vorstands entstehen, beglichen werden können. ELMOS plant auch für die kommenden Jahre ein ähnliches Stock Awards Programm.

Die Aktien wurden zwischen dem 30. Januar 2008 und 25. Februar 2008 zum Preis von EUR 5,95 je Aktie zuzüglich Provision erworben (gesamt TEUR 302) und bis zum 31. Dezember 2008 vollständig an die Mitarbeiter, Führungskräfte und Mitglieder des Vorstands ausgegeben.

Bilanzgewinn

Im Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag von EUR 39.621.311,85 enthalten; im Übrigen verweisen wir auf den unten stehenden Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns.

Rückstellungen

Die Pensionsrückstellungen wurden für ehemalige Mitglieder des Vorstands bzw. deren Hinterbliebenen gebildet.

Die Steuerrückstellungen betreffen Ertragsteuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Berufsgenossenschaftsbeiträge, Tantiemen, Garantieleistungen, Lizenzen, nachkommende Rechnungen, sonstige Personalrückstellungen und Altersteilzeitansprüche gebildet.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind im nachfolgenden Verbindlichkeitspiegel im Einzelnen dargestellt.

Die Verbindlichkeiten enthalten keine gegenüber Gesellschaftern.

Verbindlichkeitspiegel in TEUR

Art der Verbindlichkeit	gesamt 31.12.2008	Restlaufzeit			gesamt 31.12.2007
		unter 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre	
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	40.000	0	40.000	0	41.115
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	30	30	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.039	8.039	0	0	6.819
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	56.551	56.551	0	0	35.314
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	436	436	0	0	1.786
6. Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	889 (939)	734 (939)	88 (0)	67 (0)	889 (939)
- davon aus Steuern (Vorjahr)	677 (679)				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (Vorjahr)	0 (2)				

Angabe von Art und Form der Sicherheiten

Ein Darlehen über TEUR 20.000 ist durch eine auf TEUR 12.500 betragsmäßig beschränkte Bürgschaft der WestLB AG, Düsseldorf, gesichert. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind, bis auf branchenüblich verlängerte Eigentumsvorbehalte von Lieferanten, im Wesentlichen nicht besichert. Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ebenfalls nicht besichert.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse

Die Gesellschaft hatte eine Bürgschaft für eine Kreditlinie in Höhe von USD 2.000.000,00 übernommen, welche einem verbundenen Unternehmen gewährt wurde. Zum Abschlussstichtag besteht diese nicht mehr.

Die Gesellschaft hat für ein weiteres verbundenes Unternehmen eine Bürgschaft in Höhe von TEUR 11 übernommen.

Derivative Finanzinstrumente

Die Gesellschaft hatte einen Bonus Zinssatz-Swap für einen Nominalbetrag in Höhe von TEUR 20.000 und einer Laufzeit vom 14. April 2003 bis zum 14. April 2008 abgeschlossen. Gegenstand dieses Vertrages war der Tausch eines Festzinssatzes in Höhe von 5,250 % p. a. gegen einen variablen Zinssatz in Höhe der Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR-Telerate) für 3-Monatsgelder.

In 2008 wurden aus diesem Vertrag keine Erträge bzw. Aufwendungen gebucht, er endete vertragsgemäß im Geschäftsjahr. Es wurden keine weiteren derivativen Finanzinstrumente abgeschlossen.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gesellschaft hat Leasingverträge für das Betriebs- und Verwaltungsgebäude, das Mitarbeiterzentrum, das Parkhaus sowie für ein weiteres Bürogebäude abgeschlossen, deren Laufzeiten sich bis 2014, 2019, 2020, und 2021 erstrecken. Außerdem hat die Gesellschaft Leasingverträge für technische Anlagen und Maschinen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung abgeschlossen, deren Laufzeiten zwischen 2009 und 2019 enden. Daneben bestehen Leasingverträge für den Fuhrpark, Büromaschinen und technische Anlagen und Maschinen in betriebsüblichem Umfang sowie Verpflichtungen aus Rückdeckungsversicherungen.

Die Gesellschaft hat einen Vertrag über gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsleistungen sowie zur Nutzung einer Produktionslinie mit einer Laufzeit bis 2016 abgeschlossen.

Infolge der bestehenden nichtkündbaren oben genannten Verträge summieren sich die in den folgenden Jahren zu zahlenden Beträge wie folgt:

	<u>TEUR</u>
2009	24.297
2010	20.551
2011	15.061
2012	12.907
2013	9.975
Folgejahre (gesamt)	43.665

In den angegebenen Werten sind sonstige finanzielle Verpflichtungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von TEUR 353 enthalten, die sich gleichmäßig auf die Jahre 2009 - 2013 verteilen.

Aus erteilten Investitionsaufträgen besteht ein Bestellobligo von TEUR 417.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

	<u>2008</u> TEUR	<u>2007</u> TEUR
- nach Sparten		
Produktion	152.821	154.331
Entwicklung	6.208	3.533
Sonstiges	<u>410</u>	<u>488</u>
Nettoumsatzerlöse	<u>159.439</u>	<u>158.352</u>
- nach Regionen		
Inland	62.289	61.446
Übrige EU-Länder	62.648	58.244
USA	9.131	11.928
Übrige Länder	<u>25.371</u>	<u>26.734</u>
Nettoumsatzerlöse	<u>159.439</u>	<u>158.352</u>

Außerplanmäßige Abschreibungen

Auf Gegenstände des immateriellen Anlagevermögens wurden im Geschäftsjahr außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von TEUR 1.050 vorgenommen.

Sonstige betriebliche Erträge

Bei den periodenfremden Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (TEUR 871), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (TEUR 53) und Erträge aus Anlageabgängen (TEUR 6).

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bei den periodenfremden Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen aus Garantieleistungen (TEUR 835), Forderungsverluste (TEUR 810) sowie das Jahr 2007 betreffende Gutschriften (TEUR 634) und Nachbelastungen Vorjahre (TEUR 28).

Honorare für Abschlussprüfer

Das im Geschäftsjahr als Aufwand erfasste Honorar für Abschlussprüfer gliedert sich auf in die Bereiche Abschlussprüfung (TEUR 124), sonstige Bestätigungs- oder Bewertungsleistungen (TEUR 74) sowie Steuerberatungsleistungen (TEUR 155).

In den sonstigen Bestätigungs- oder Bewertungsleistungen sind u. a. Honorare für die Prüferische Durchsicht des Konzernzwischenabschlusses zum 30. Juni 2008 enthalten.

Sonstige Angaben

Aufsichtsrat

Prof. Dr. Günter Zimmer, Duisburg, Diplom-Physiker, (Vorsitzender)
Universitätsprofessor i.R.

Dr. Burkhard Dreher, Dortmund, Diplom-Volkswirt (stellvertretender Vorsitzender)
Selbstständiger Volkswirt

Jörns Haberstroh, Kerken, Diplom-Ökonom
Management Consultant

Dr. Peter Thoma, Unterschleißheim, Diplom-Physiker
Consultant Automotive Electronics

Jutta Weber, Tarrytown, New York, Diplom-Pädagogin
Erzieherin

Dr. rer. nat. Klaus Weyer, Diplom-Physiker
Management Consultant

Herr Prof. Dr. Günter Zimmer übt 2 weitere Aufsichtsratsmandate (Siltronic AG, Dolphin Intégration S.A.), Herr Dr. Burkhard Dreher weitere 2 (Vattenfall Europe Mining AG, Arcelor Mittal Eisenhüttenstadt GmbH), Herr Jörns Haberstroh ein weiteres Mandat (Ehlebracht AG) und Herr Dr. Peter Thoma ein weiteres Mandat aus (Kromberg & Schubert GmbH & Co. KG). Herr Dr. Weyer übt 2 Aufsichtsratsmandate aus (Aufsichtsrat der Paragon AG, Projektbeirat der MST Dortmund).

Vorstand

Diplom-Physiker Dr. rer. nat. Anton Mindl, Lüdenscheid
Vorstandsvorsitzender

Diplom-Ingenieur Reinhard Senf, Iserlohn
Vorstand für Produktion

Diplom-Volkswirt Nicolaus Graf von Luckner, Oberursel
Vorstand für Finanzen

Diplom-Ingenieur Dr. rer.-nat. Frank Rottmann, Dortmund (bis 30. April 2008)
Vorstand für Vertrieb und Entwicklung

Jürgen Höllisch, Purbach am Neusiedlersee (seit 1. Oktober 2008)
Vorstand für Vertrieb und Entwicklung

Gesamtbezüge des Vorstands

Die Bezüge des Vorstands teilen sich in fixe Bezüge und variable, erfolgsorientierte Bezüge auf, die sich auf Ergebnisgrößen des ELMOS Konzerns beziehen. Demnach betragen die Bezüge des Vorstands für 2008 insgesamt TEUR 1.810. Hiervon entfallen auf den fixen Bestandteil TEUR 1.244 und auf den variablen Teil TEUR 525. Für Mitglieder des Vorstands bestehen mittelbare Pensionszusagen, für die aufgrund der vollständig kongruenten Rückdeckung durch eine Rückdeckungsversicherung keine Pensionsrückstellung zu bilden ist. In 2008 beliefen sich die Beiträge für diese Pensionspläne auf TEUR 366, die im fixen Bestandteil der Bezüge enthalten sind. Aus dem Gratisaktien-Programm (Stock Awards) wurden den Vorstandsmitgliedern 14.139 Aktien mit einem Zeitwert zum Zeitpunkt ihrer Gewährung in Höhe von insgesamt TEUR 41 übertragen.

In der Hauptversammlung vom 19. Mai 2006 wurde mit einer $\frac{3}{4}$ -Mehrheit beschlossen, die Angaben gemäß § 285 I Nr. 9a Satz 5 - 9 HGB für die folgenden 5 Jahre zu unterlassen.

Die Bezüge für frühere Vorstandsmitglieder bzw. ihrer Hinterbliebenen betragen im Geschäftsjahr 2008 TEUR 255. Ferner wurden für diese Versicherungsprämien in Höhe von TEUR 275 entrichtet, die gebildete Pensionsrückstellung beträgt TEUR 1.895.

Die Mitglieder des Vorstandes halten die folgende Anzahl an Aktien der ELMOS Semiconductor AG, Dortmund:

	Aktien	Aktienoptionen
Dr. Anton Mindl	103.725	0
Reinhard Senf	16.923	25.000
Nicolaus Graf von Luckner	10.614	0
Jürgen Höllisch	0	0

Gesamtbezüge des Aufsichtsrats

Die fixen Bezüge (inkl. Spesen und Auslagen) des Aufsichtsrats beliefen sich für 2008 insgesamt auf TEUR 82, es wurde keine variable Vergütung gezahlt.

An Aufsichtsratsmitglieder wurden in 2009 keine Aktienoptionen und keine Gratisaktien ausgegeben.

Für sonstige Dienstleistungen – insbesondere Beratungen – vergütete die Gesellschaft an Mitglieder des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2008 TEUR 342.

Die folgenden Mitglieder des Aufsichtsrates halten die angegebene Anzahl an Aktien der ELMOS Semiconductor AG, Dortmund:

	Aktien	Aktienoptionen
Prof. Dr. Günter Zimmer	0	0
Dr. Burkhard Dreher	5.000	0
Jörns Haberstroh	3.956	0
Dr. Peter Thoma	9.200	25.000
Jutta Weber	200	0
Dr. Klaus Weyer	87.500	25.000

Mitglieder des Aufsichtsrats hielten zusammen indirekt 33,6 % der Aktien der Gesellschaft.

Meldepflichtige Wertpapiergeschäfte

Die folgenden meldepflichtigen Wertpapiergeschäfte fanden in 2008 statt:

Datum Ort	Name	Funktion	Transaktion	Stückzahl	Kurs / Basispreis (Euro)	Gesamt-volumen (Euro)
15.05.2008 Frankfurt/Main	Dr. Burkhard Dreher	Aufsichtsratsmitglied	Kauf	3.100	6,40	19.840
17.10.2008 außerbörslich	Dr. Klaus Weyer	Aufsichtsratsmitglied	Kauf	109.500	3,15	344.925
17.10.2008 außerbörslich	Prof. Dr. Günter Zimmer	Aufsichtsratsvorsitzender	Kauf	109.500	3,15	344.925
20.10.2008 außerbörslich	Dr. Anton Mindl	Vorstandsvorsitzender	Kauf	50.000	3,15	157.500
20.10.2008 außerbörslich	Dr. Klaus Weyer	Aufsichtsratsmitglied	Kauf	50.000	3,1465	157.325
20.10.2008 außerbörslich	Prof. Dr. Günter Zimmer	Aufsichtsratsvorsitzender	Kauf	50.000	3,1465	157.325
23.10.2008 Frankfurt/Main	Nicolaus Graf von Luckner	Vorstandsmitglied	Kauf	1.000	3,15	3.150
30.10.2008 Frankfurt/Main	Reinhard Senf	Vorstandsmitglied	Kauf	10.000	3,05	30.500
30.10.2008 außerbörslich	Prof. Dr. Günter Zimmer	Aufsichtsratsvorsitzender	Verkauf	159.500	k. A.	k. A.
30.10.2008 außerbörslich	ZOE Beteiligungs GmbH	Juristische Person in enger Beziehung zu Aufsichtsratsvorsitzendem	Kauf	159.500	k. A.	k. A.
13.11.2008 außerbörslich	Dr. Anton Mindl	Vorstandsvorsitzender	Übertragung (Stock Awards)	4.500	2,93	13.185

Datum Ort	Name	Funktion	Transaktion	Stückzahl	Kurs / Basispreis (Euro)	Gesamt- volumen (Euro)
13.11.2008 außerbörslich	Reinhard Senf	Vorstandsmitglied	Übertragung (Stock Awards)	3.000	2,93	8.790
13.11.2008 außerbörslich	Nicolaus Graf von Luckner	Vorstandsmitglied	Übertragung (Stock Awards)	6.639	2,93	19.452
21.11.2008 außerbörslich	Dr. Anton Mindl	Vorstandsvorsitzender	Kauf	30.000	2,45	73.500
21.11.2008 außerbörslich	Dr. Klaus Weyer	Aufsichtsratsmitglied	Kauf	50.000	2,45	122.500
21.11.2008 außerbörslich	ZOE Beteili- gungs GmbH	Juristische Person in enger Beziehung zu Auf- sichtsratsvorsitzendem	Kauf	178.355	2,45	436.970
11.12.2008 außerbörslich	Dr. Klaus Weyer	Aufsichtsratsmitglied	Kauf	28.000	2,10	58.800
11.12.2008 XETRA	Dr. Anton Mindl	Vorstandsvorsitzender	Kauf	4.000	2,02	8.080
12.12.2008 XETRA	Dr. Anton Mindl	Vorstandsvorsitzender	Kauf	3.000	2,00	6.000
18.12.2008 außerbörslich	Dr. Klaus Weyer	Aufsichtsratsmitglied	Verkauf	160.000	2,00	320.000
18.12.2008 außerbörslich	Elisabeth Weyer	Ehefrau eines Aufsichtsrats- ratsmitglieds	Kauf	160.000	2,00	320.000
23.12.2008 außerbörslich	ZOE Beteili- gungs GmbH	Juristische Person in enger Beziehung zu Auf- sichtsratsvorsitzendem	Verkauf	160.000	k. A.	k. A.
23.12.2008 außerbörslich	Elke Zimmer	Natürliche Person in en- ger Beziehung zu Auf- sichtsratsvorsitzendem	Kauf	160.000	k. A.	k. A.

Mitarbeiter

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter beträgt in den Funktionsbereichen:

	<u>2008</u>
Produktion	437
Vertrieb	52
Verwaltung	58
Qualitätswesen	37
Forschung & Entwicklung	<u>143</u>
	<u><u>727</u></u>

Konzernverhältnisse

Die ELMOS Semiconductor AG, Dortmund, befindet sich im mittelbaren Mehrheitsbesitz der EFH ELMOS Finanzholding GmbH, Dortmund, die nach § 290 Abs. 2 Nr. 2 HGB zur Aufstellung eines Konzernabschlusses verpflichtet ist. Die Aufstellung eines Konzernabschlusses durch die EFH ELMOS Finanzholding GmbH, Dortmund, zum 31. Dezember 2008 erfolgte bislang nicht.

Gewinnverwendungsvorschlag

Der Vorstand schlägt (in Übereinstimmung mit dem Aufsichtsrat) vor, den Bilanzgewinn von EUR 36.713.349,40 auf neue Rechnung vorzutragen.

Erklärung gemäß § 161 AktG zum Corporate-Governance-Kodex

Vorstand und Aufsichtsrat der ELMOS Semiconductor AG, Dortmund, haben die nach § 161 AktG vorgeschriebene Erklärung abgegeben und den Aktionären zugänglich gemacht.

Dortmund, im März 2009

Der Vorstand

Dr. Anton Mindl Nicolaus Graf von Luckner Reinhard Senf Jürgen Höllisch

Entwicklung des Anlagevermögens 2008

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				30.12.2004 EUR	31.12.2003 EUR	Zugänge EUR	Kumulierte Abschreibunge Abgänge 30.12.2004 EUR	Buchwerte		
	31.12.2003 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR					30.12.2004 EUR	31.12.2007 TEUR	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
1. Software und Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte	27.549.432,82	2.773.848,49	967.924,18	6.712,80	31.284.492,69	15.816.211,19	4.292.063,85	2.736,94	20.105.538,10	11.178.954,59	11.733
2. Geleistete Anzahlungen	2.025.342,81	719.099,41	-1.417.185,87	0,00	1.327.256,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327.256,35	2.025
	29.574.775,63	3.492.947,90	-449.261,69	6.712,80	32.611.749,04	15.816.211,19	4.292.063,85	2.736,94	20.105.538,10	12.506.210,94	13.758
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke und Bauten	16.348.196,72	299.844,47	899.036,10	0,00	17.547.077,29	5.502.074,72	1.514.240,87	0,00	7.016.315,59	10.530.761,70	10.846
2. Technische Anlagen und Maschinen	109.155.523,19	2.002.702,48	8.245.278,41	435.736,34	118.967.767,74	76.140.726,44	7.045.001,98	305.217,41	82.880.511,01	36.087.256,73	33.015
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.881.725,04	542.664,99	65.067,35	369.103,01	10.120.354,37	7.027.336,06	997.049,01	355.909,68	7.668.475,39	2.451.878,98	2.854
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.508.444,32	11.809.458,67	-9.209.381,86	22.087,56	11.086.433,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.086.433,57	8.509
	143.893.889,27	14.654.670,61	0,00	826.926,91	157.721.632,97	88.670.137,22	9.556.291,86	661.127,09	97.565.301,99	60.156.330,98	55.224
III. Finanzanlagen											
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	63.349.420,79	0,00	0,00	22.002.876,00	41.346.544,79	0,00	0,00	0,00	0,00	41.346.544,79	63.350
2. Beteiligungen	541.317,98	0,00	449.261,69	5.500,00	985.079,67	486.492,57	0,00	0,00	486.492,57	498.587,10	55
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	304.140,84	161.944,06	0,00	0,00	466.084,90	0,00	0,00	0,00	0,00	466.084,90	304
4. Sonstige Ausleihungen	0,00	26.333.498,02	0,00	0,00	26.333.498,02	0,00	0,00	0,00	0,00	26.333.498,02	0
5. Rückdeckungsansprüche aus Lebensversicherungen	1.627.138,00	192.045,96	0,00	77.591,96	1.741.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741.592,00	1.627
	65.822.017,61	26.687.488,04	449.261,69	22.085.967,96	70.872.799,38	486.492,57	0,00	0,00	486.492,57	70.386.306,81	65.336
	239.290.682,51	44.835.106,55	0,00	22.919.607,67	261.206.181,39	104.972.840,98	13.848.355,71	663.864,03	118.157.332,66	143.048.848,73	134.318

Lagebericht für 2008

Geschäft und Rahmenbedingungen

Geschäftstätigkeit

ELMOS entwickelt, produziert und vertreibt hochintegrierte mikroelektronische Schaltkreise. Das Unternehmen wurde im Jahr 1984 in Dortmund gegründet und hat dort seinen Hauptsitz sowie den größten Produktionsstandort. Die Produkte – sogenannte Halbleiter – werden vornehmlich in zwei Branchen eingesetzt: rund 90 Prozent des Umsatzes wird mit Elektronik für die Automobilindustrie erzielt, die restlichen zehn Prozent werden in Produkten für den Markt der Industrie- und Konsumgüterelektronik integriert.

ELMOS: der Spezialist für Automobilelektronik

Der Anteil der Elektronik im Auto erhöht sich stetig: Komfortanwendungen wie Einparkhilfen, Klimaanlage oder Zentralverriegelungen sind heute selbstverständliche Bestandteile moderner Fahrzeuge geworden. Insbesondere die Sicherheitselektronik hat in den vergangenen Jahren Quantensprünge vollzogen. Vom ersten – noch viel diskutierten Airbag – bis zur heutigen Ausstattung mit ABS, ESP und vielen weiteren Funktionen. In den kommenden Jahren wird – ungeachtet der aktuellen Preissituation für Kraftstoffe – vor allem der geringere Verbrauch im Mittelpunkt stehen. Weitere Einsparungen sind hier nur durch den intelligenten Einsatz von Elektronik zu erzielen.

ELMOS entwickelt und produziert Halbleiter-Chips und Sensoren, also die Intelligenz für die Automobil-Elektronik. Unsere Chips regeln, steuern und messen die Systeme. Beispiel Antriebsanwendung: Hier zeichnen sich unsere Lösungen durch hochpräzise analoge Eingangsverstärker, Leistungsendstufen und integrierte Mikroprozessoren aus – alles, was eine moderne Elektronik benötigt, um das Autofahren so umweltfreundlich und effizient wie möglich zu gestalten. Daher finden sich ELMOS-Chips in fast allen Automobilmarken weltweit.

Ein Merkmal der Halbleiter für den Automobilmarkt ist die lange Produktionszeit. Automobile Neuprojekte benötigen in der Regel zwei bis drei Jahre Entwicklungszeit, bevor sie für etwa fünf bis acht Jahre in Serie produziert werden. Teilweise verlängert sich diese Produktionszeit erheblich, wenn Autohersteller eine ähnliche technische Plattform in einer Familie von neuen Modellen einsetzen. ELMOS kann aufgrund von speziellen Produktionsmöglichkeiten ihre Kunden – im Gegensatz zu vielen anderen Halbleiterherstellern – über den kompletten Zeitraum mit demselben Chip bedienen. Weitere Merkmale unseres Geschäfts sind die sehr hohen Qualitätsanforderungen sowie die robuste Halbleitertechnologie.

Seit ihrer Gründung hat sich ELMOS eine führende Marktposition als Halbleiterhersteller im Markt für Automobilelektronik erarbeitet. Basierend auf einer Studie des Marktforschungsinstituts Gartner Dataquest aus dem März 2008 wird ELMOS als die weltweite Nummer zwei im Segment der ASICs (Application Specific Integrated Circuits) für den Automobilmarkt gleichauf mit Denso geführt. Die Rangliste wird angeführt von STMicroelectronics, die direkten Wettbewerber AMI Semiconductor (zwischenzeitlich gekauft von ON Semiconductor) und Melexis folgen auf den Plätzen fünf bzw. sieben. ELMOS konnte ihren Marktanteil von zehn auf elf Prozent steigern. Bei sehr hohen Stückzahlen steht ELMOS auch in Konkurrenz zu großen Halbleiterherstellern wie Infineon, STMicroelectronics und Freescale.

Potenzial im Industrie- und Konsumgüterbereich

Neben dem automobilen Markt ist ELMOS im Industrie- und Konsumgüterbereich tätig und liefert Halbleiter z.B. für Anwendungen in Haushaltsgeräten, Fotoapparaten, Installations- und Gebäudetechnik und Maschinensteuerungen. Dieser nicht-automobile Bereich hat im vergangenen Jahr, wie in den Vorjahren, rund 10% des Umsatzes ausgemacht. Der Umsatzanteil soll mittelfristig auf 20% bis 30% steigen.

Kunden- und applikationsspezifische Bausteine

Unabhängig vom Zielmarkt entwickelt und produziert ELMOS überwiegend Produkte im Kundenauftrag für eine spezielle Anwendung exklusiv für den jeweiligen Kunden. Neben diesen kundenspezifischen Schaltkreisen (ASICs), die mehr als 90% der Produkte umfassen, verfügt ELMOS zudem über ein Portfolio von anwendungsspezifischen Standardprodukten (ASSPs). ELMOS produziert ASICs und ASSPs bislang fast ausschließlich in den eigenen Produktionsstätten (Wafer-Fabs) in Dortmund und Duisburg. Je nach Kapazitätsbedarf kann in den kommenden Jahren auch zusätzlich ein Dienstleister die automobilen Halbleiter in unserem Auftrag (sog. Foundry-Dienstleistungen) fertigen.

Umfangreiches Produktportfolio

Der Großteil des Umsatzes wird mit Halbleitern erwirtschaftet; ergänzt wird dieses Produktportfolio durch Mikromechanische Bauelemente (MEMS). Hierbei handelt es sich überwiegend um hochpräzise Drucksensoren in Silizium, die durch unsere Tochtergesellschaft Silicon Microstructures (SMI)/ Milpitas, USA, entwickelt, produziert und vertrieben werden. Darüber hinaus unterstützt die produzierende Tochterfirma ELMOS Advanced Packaging B.V. (ELMOS AP) mit Sitz in Nijmegen, Niederlande, das Technologie- und Produktportfolio mit der Entwicklung und Fertigung von Spezialgehäusen für elektronische Halbleiterkomponenten und Sensoren. Die Entwicklung und Vermarktung von anwendungsspezifischen, mikro-mechatronischen Bauteilen runden die Produktpalette ab. Diese Mikrosysteme kombinieren die Fähigkeiten der ELMOS-Gruppe und bestehen aus signalverarbeitenden Halbleiterbauelementen und mikromechanischen Sensoren in einem

funktionalen Gehäuse. Damit kann der Kunde kostengünstige Systemlösungen realisieren.

Strategie

Auch im Jahr 2008 wurde weiter an der Umsetzung der eingeschlagenen Strategie gearbeitet. Auch vor dem Hintergrund der gegenwärtig schwierigen wirtschaftlichen Lage halten wir an diesem Vorgehen fest. Wir sind davon überzeugt, dass sich die Investitionen in die Umsetzung unserer Strategie auch aus wirtschaftlicher Sicht bezahlt machen. Wir können auf der Basis einer soliden Liquiditätslage und bilanziellen Stärke agieren. Die strategischen Eckpfeiler und deren Fortschritte werden nachfolgend umrissen.

Vom Entwicklungslieferanten zum Produktgeschäft

Während vor einigen Jahren noch ASICs die Regel waren und Kunden sich an den Entwicklungskosten der Produkte signifikant beteiligt haben, stehen heute die ASSPs im Fokus. Um dieser Entwicklung gerecht zu werden und erfolgreich im Markt zu agieren, haben wir seit einigen Jahren vermehrt ASSPs entwickelt. Deren Umsatzanteil liegt derzeit noch auf einem niedrigen Niveau, steigt jedoch stetig. Die Entwicklung und der Vertrieb von ASSPs erfordern eine stark abgewandelte Organisationsstruktur und auch ein Umdenken bei den Mitarbeitern. Nicht mehr die Kunden spezifizieren, was entwickelt wird, sondern Markttrends müssen erkannt und in Produkte umgesetzt werden. Die Organisation wird dieser Veränderung angepasst. Produktfamilien spezialisiert auf die verschiedenen Applikationen „Sense“, „Drive“, „Connect“ und „Supply“ – aber standardisiert für verschiedene Kunden – wurden definiert und Entwicklungen initiiert. Momentan sind etwa [50] ASSPs verfügbar und [15] weitere befinden sich in der Entwicklung. Einsatzgebiete dieser Produkte sind beispielsweise Effizienzsteigerung (z.B. Multi-Phasen Booster zur LED Steuerung), Gebäudetechnologie (z.B. CO₂-Sensoren für das Temperaturmanagement) oder Sicherheitsapplikationen (z.B. Crash Airbag Sensoren). Der Eintritt in die ASSP-Märkte ermöglicht eine im ASIC-Markt nicht erschließbare Hebelwirkung in Bezug auf Volumina und Margen.

Stärkerer Einstieg in Industrie- und Konsumgütermärkte

Unsere Stärke liegt historisch im Automobilmarkt. Wir sehen für unsere Produkte jedoch auch erhebliche, bisher nicht adressierte Chancen in Industrie- und Konsumgütermärkten. Um unsere Möglichkeiten zu nutzen, haben wir unsere Anstrengungen in diesem Bereich signifikant gestärkt. Wir haben zusätzliche Distributoren unter Vertrag genommen, um die Kundenbasis zu verbreitern. Zudem zielen wir mit unserem eigenen auf die Industrie- und Konsumgütermärkte spezialisierten Vertriebsteam auf Schlüsselkunden in diesen Märkten. Als Erfolg konnten im vergangenen Jahr zahlreiche neue Projekte akquiriert werden. Großes Kundeninteresse finden wir in den Bereichen Netzwerksysteme, Lichtkonzepte und

Spannungsversorgung. Mittelfristig sollen die nicht-automobilen Märkte 20-30% des Umsatzes der ELMOS ausmachen.

Erschließung der asiatischen Märkte

Bislang sind wir stark auf dem deutschen und den weiteren europäischen Märkten aufgestellt. Im US-amerikanischen Markt haben wir Fuß gefasst und gute Kontakte etabliert. Die Erschließung des asiatischen Markts, und dabei insbesondere des japanischen und südkoreanischen, haben wir in den letzten Jahren forciert. Hierzu haben wir unsere Vertriebsaktivitäten durch eigene Mitarbeiter und Repräsentanten gestärkt und eine strategische Partnerschaft mit Autonet, einem bedeutenden Zulieferer an die Automobilhersteller Hyundai und Kia, geschlossen. Diese Aktivitäten haben dazu geführt, dass wir zahlreiche Design Wins verbuchen konnten, die zukünftig zu einem größeren Umsatzanteil der asiatischen Märkte führen werden.

Einstieg in strategische Partnerschaften

Durch strategische Kooperationen mit Partnern können wir unsere eigenen Fähigkeiten sinnvoll ergänzen, um langfristig ein breiteres Produktportfolio anbieten zu können und damit unsere Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Im vergangenen Jahr haben wir zwei Partnerschaften vertraglich vereinbart. Anfang des Jahres unterzeichneten wir einen Kooperationsvertrag mit der koreanischen Foundry MagnaChip. Gemeinsam entwickeln wir zum einen eine neue Technologiegeneration und zum anderen ermöglicht uns diese Partnerschaft, fertig prozessierte Wafer zu beziehen, um dadurch mittelfristig unseren Investitionsbedarf zu reduzieren und flexibler auf stark schwankende Stückzahlen reagieren zu können. Diese zusätzlichen Fremdfertigungskapazitäten ermöglichen ELMOS in Kombination mit der eigenen Produktion die Umsetzung eines sog. Fab-light Konzepts. Die im Herbst geschlossene Vereinbarung mit NEC Electronics umfasst die gemeinsame Entwicklung, die wechselseitige Nutzung von Entwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen sowie die gemeinschaftliche Vermarktung von Produkten für den Automobil- und Industriemarkt. Die Kunden beider Unternehmen werden insbesondere davon profitieren, dass die Stärken der NEC Electronics im Bereich von 8- bis 32-bit Mikrocontrollern, mit den robusten und zuverlässigen, anwendungsspezifischen, analog/mixed-signal Halbleiterchips von ELMOS kombiniert werden können.

Größerer Anteil an Mikrosystemen

Mikrosysteme, bestehend aus ASICs und MEMS in einem kundenspezifischen Package, werden in den kommenden Jahren eine steigende Nachfrage erfahren. ELMOS ist als eines der wenigen Unternehmen in der Lage, Mikrosysteme in der ELMOS-Gruppe vollständig zu entwickeln und zu produzieren. In den vergangenen Geschäftsjahren wurde die Entwicklung der Mikrosystem-Projekte soweit vorangetrieben, dass in 2009 ein Mikrosystem für eine Sicherheitsanwendung in Serie geht. Zudem konnte in 2008 ein erstes Standard-Mikrosystem, ein für die

Industrie-, Medizin- und Automobilmärkte einsetzbares Drucksensorsystem, im Markt vorgestellt werden.

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Der für ELMOS wichtigste Markt ist der der Halbleiter für die Automobilindustrie, ein Nischenmarkt der globalen Halbleiterindustrie. Er umfasst weltweit einen Anteil von rund 7% des gesamten Halbleitermarkts.

Der Automobilmarkt entwickelte sich während der ersten Jahreshälfte 2008 noch zufriedenstellend, allerdings gab es im Herbst die ersten signifikanten Anzeichen des Übergreifens der Schwäche aus der Finanzmarktkrise auf die Realwirtschaft. Die Automobilindustrie wurde als eine der ersten Branchen erfasst; der Rückschlag war überraschend heftig. So gingen die Zulassungszahlen in 2008 weltweit gerade gegen Ende des Jahres stark zurück. Die hochentwickelten Märkte Westeuropa und USA sind von den Rückgängen überproportional erfasst worden.

In **Europa** gingen die Zulassungszahlen in 2008 um 7,8% zurück; dies entspricht dem größten Rückgang seit 15 Jahren. In Westeuropa betrug der Rückgang 8,4% im gesamten Jahr; im vierten Quartal 2008 sanken die Zulassungszahlen sogar um 19,3%. Von den größten europäischen Märkten verzeichneten Spanien (-28,1%), Italien (-13,4%) und Großbritannien (-11,3%) drastische Einbrüche in 2008. Deutschland (-1,8%) und Frankreich (-0,7%) meldeten etwas moderatere Rückgänge. Die Absatzzahlen aller großen Automobilhersteller sind in 2008 in Europa rückläufig gewesen.

Der **US-Markt** ist im Jahr 2008 um 18% eingebrochen. Obwohl auch die deutschen Marken Rückgänge in den USA (-6%) zu verzeichnen hatten, konnten sie wie in den vergangenen Jahren wieder Marktanteile hinzugewinnen. Die Verkaufszahlen der amerikanischen Automobilhersteller brachen in 2008 um 20% bis 30% ein.

Für das Jahr 2009 reichen die derzeitigen Prognosen für die Entwicklung der Automobil-Zulassungszahlen von -8% bis zu -25%. Die Schwankungsbreite der Erwartungen deutet auf die hohe Unsicherheit in Bezug auf die gegenwärtige Lage hin. Wann die derzeitige Konjunkturschwäche überwunden sein wird, ist aktuell unklar. Das Marktforschungsinstitut Gartner erwartet, dass der Markt für automobiler Halbleiter in 2009 um 16% (Prognose aus Januar 2009) sinken wird.

In der Regel wächst der automobiler Halbleitermarkt selbst bei konstanter Automobilproduktion. Dies ist begründet durch den stetig steigenden Anteil elektronischer Systeme im Automobil. Die derzeitige Marktlage ist jedoch davon gekennzeichnet, dass der Umsatzrückgang der Zulieferer noch deutlich größer ist als der der Automobilhersteller. Vermutlich ist eine Leerung der in der Lieferkette befindlichen Lager die Ursache. Es ist

davon auszugehen, dass sich die Entwicklung von Produktionszahlen der Automobilhersteller und Absatzzahlen der Zulieferer in näherer Zukunft zumindest wieder annähert.

Produktion

Während der Umsatz des ELMOS-Konzerns 2008 in etwa auf Vorjahresniveau stabil geblieben ist, hat sich die Anzahl der produzierten Chips gegenüber dem Vorjahr weiter erhöht. In den vergangenen Jahren haben wir eine zweite Halbleiterproduktionsstätte in Duisburg aufgebaut, die sowohl zur Absicherung der Versorgung als auch für die Nutzung der Kostensenkungspotenziale aufgrund eines größeren Waferdurchmessers bedeutend ist. Die Produktion in Duisburg, die im Jahr 2007 hochgefahren wurde, wurde im Laufe des ersten Halbjahres 2008 sukzessive weiter ausgelastet. Die Produktionseffizienz wurde im Verlauf der Quartale weiter gesteigert. Der Anteil der auf der 200mm-Produktionslinie (entspricht 8-Zoll) in Duisburg produzierten Produkte hat sich im Berichtsjahr verdoppelt und machte in etwa ein Fünftel der gesamten ELMOS-Chip Produktion aus.

An beiden Chipproduktionsstandorten Dortmund und Duisburg wurde im letzten Quartal 2008 die Wafereinstellung aus wirtschaftlichen Gründen zurückgefahren; somit ist die Auslastung im Berichtsjahr deutlich hinter den ursprünglichen Planungen zurück geblieben. Als Folge wurden ursprünglich geplante Investitionen zum Kapazitätsausbau verschoben bzw. eingestellt. Die vorgesehene Umstellung eines Teils der Fertigung in Dortmund von 150mm (entspricht 6-Zoll) auf 200mm (entspricht 8-Zoll) wurde in die Folgejahre verschoben, da die erhöhte Kapazität momentan nicht erforderlich ist.

Die eigenen Fertigungsstätten werden komplettiert durch Kooperationen mit Auftragsfertigungen (Foundries). Zukünftig stellen diese möglicherweise zusätzlich benötigte Kapazitäten zur Verfügung und ermöglichen es ELMOS, flexibel auch auf stärker schwankende Nachfrage reagieren zu können. Die Möglichkeit der Produktion bei einem Foundry-Partner soll insbesondere auch für ASSPs und für Produkte im Industrie- und Konsumgüterbereich wahrgenommen werden.

Forschung und Entwicklung

Die immer intensivere Nutzung von elektronischen Komponenten im Automobil führt zu kontinuierlich steigenden Anforderungen der Automobilindustrie an Qualität und Zuverlässigkeit bei Halbleitern in der Automobilelektronik. ELMOS nutzt z.B. in Konsumgütermärkten gereifte Innovationen für die Einführung im Automobil, die durch eigene Qualifikationsverfahren zusätzlich abgesichert werden, um das in der Automobilindustrie hohe Qualitätsniveau sicherzustellen.

Im Berichtsjahr wurde der 0,35µm Prozess weiterentwickelt. Ein weiterer Schwerpunkt war die im Rahmen der Kooperation mit der

südkoreanischen MagnaChip gemeinsame Entwicklung von automobilen Halbleitertechnologien. Darüber hinaus ist die Weiterentwicklung von Technologiemodulen für den 0,35µm Prozess zentrales Thema der Forschung und Entwicklung.

Neben den Entwicklungen neuer Prozesse entfällt der mit Abstand größere Teil der Aufwendungen für Forschung und Entwicklung auf die Entwicklung neuer Produkte. Der Großteil der Produktentwicklungskosten, die bei ELMOS anfallen, wird von uns vorfinanziert und muss sich über die Serienfertigung amortisieren. Dies trifft natürlich in besonderem Maße für die Entwicklung von applikationsspezifischen Standardprodukten zu, die zukünftig einen größeren Umsatzanteil von ELMOS ausmachen werden.

Mitarbeiter

Das Know-how der Mitarbeiter ist für ELMOS als Technologieunternehmen in besonderem Maße entscheidend. Deren Motivation, Wissen und Flexibilität sind die Voraussetzung für den langfristigen Erfolg des Unternehmens. Besonders in der Entwicklung neuer Produkte und Verfahren sind die Mitarbeiter das entscheidende Kriterium für das Wachstum und die Innovationskraft. An den Standorten Dortmund und Duisburg in Nordrhein-Westfalen, im bevölkerungsreichsten Bundesland, kann ELMOS auf eine große Zahl von gut ausgebildeten Jungingenieuren zugreifen, denn im näheren Umkreis befinden sich mehr als fünfzig Universitäten und Hochschulen. Schon seit der Gründung kooperiert ELMOS eng mit diesen und genießt als einziger Halbleiterhersteller der Region eine Ausnahmestellung. ELMOS bildet in zahlreichen technischen und kaufmännischen Berufen aus, mit Schwerpunkt auf dem Beruf des Mikrotechnologen.

Die Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Mitarbeitern erfolgt in Dortmund vertrauensvoll mit Unterstützung einer Mitarbeitervertretung. In Ausschüssen werden die Belange der Mitarbeiter untereinander und im Verhältnis zum Vorstand besprochen und geregelt. So gibt es Ausschüsse für soziale Fragen, Personalangelegenheiten, Mitarbeiterförderung und Wirtschaft.

Mitarbeiterbeteiligung

Die in 2007 eingeführten Gratisaktien wurden auch in 2008 an besonders verdiente Mitarbeiter, Führungskräfte und Mitglieder des Vorstands in Anerkennung für die im Vorjahr erbrachte Leistung vergeben. Die Gewährung dieser Awards soll zum einen die Verbundenheit von ELMOS mit ihren Leistungsträgern zeigen und zum anderen als Motivation für das Engagement und die Leistungsbereitschaft verstanden werden. Das Stock Award Programm 2008 umfasste 50.000 Aktien, die zuvor an der Börse im Rahmen der Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien zurückerworben wurden.

Qualität, Sicherheit und Umweltschutz

Im Rahmen von kontinuierlichen Verbesserungsprozessen setzt ELMOS konsequent seine First-Time-Right- und Null-Fehler-Strategie um. Jede Art von Verschwendung wird konsequent im Ansatz eliminiert. ELMOS erzielt damit ein hervorragendes Qualitätsniveau sowohl in seinen Produkten als auch in seinen Geschäfts- und Produktionsprozessen. Durch vorausschauende Qualitätsplanung und Überwachung der Kundenanforderungen schon in der Entwicklungsphase wird Qualität nicht nachträglich durch Selektion erreicht, sondern von Beginn an wettbewerbsfähig mit minimiertem Ausschuss produziert.

Regelmäßige Prüfungen der eingesetzten Prozesse und Werkzeuge, die lückenlose Betreuung der Serienprodukte von der Akquisition über die Entwicklung bis zur Fertigung und Lieferung, ständige Analysen und modernste statistische Verfahren ermöglichen dieses hohe Qualitätsniveau. Durch eine ausgefeilte Rückverfolgbarkeit ist ELMOS in der Lage, Ursachen kleinster Qualitätsschwankungen frühzeitig zu erkennen und deren Folgen wirksam und nachhaltig zu minimieren und die Kunden effizienter zu unterstützen. Interne Labore prüfen nicht nur mögliche Fehlermechanismen der Halbleiterfertigung mit hoher Produktivität, sondern auch Sensor- und Gehäuse-spezifische Merkmale und schließen so den Regelkreis zur kontinuierlichen Steuerung der ELMOS-Produktionsprozesse.

Das ELMOS Qualitätsmanagementsystem wird jährlich gemäß den Anforderungen der DIN ISO 9001 und der Normen QS 9000 und VDA 6.1 auditiert. Diese Normen wurden in der ISO/TS 16949: 2002, die weltweite Gültigkeit hat, zusammengefasst. Die wesentlichen Standorte der ELMOS-Gruppe wurden in 2008 gemäß dieser Norm auditiert und zertifiziert.

Das Umweltmanagement gemäß DIN EN ISO 14001 wurde am Standort Dortmund erstmalig in 2003 durch den TÜV Rheinland zertifiziert und in den nachfolgenden Jahren durch Überwachungsaudits ohne Abweichungen bestätigt. Die Bereiche Arbeits- und Umweltschutz sind direkt dem Vorstand unterstellt. Die ISO 14001 verankert den Umweltschutz systematisch und dauerhaft im Management. ELMOS legt beim Umweltmanagement besonderen Wert auf eine effektive Prävention sowie eine effiziente Ausnutzung von Ressourcen.

Beziehungen zu verbundenen Unternehmen

Die ELMOS Finanzholding GmbH (EFH) ist mit einem mittelbaren und unmittelbaren Anteilsbesitz von 52,9 Prozent größter Einzelaktionär der ELMOS Semiconductor AG. Daher hat der Vorstand gemäß §§312/313 AktG einen Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgestellt, der mit folgender Erklärung gemäß §312 Abs. 3 AktG abschließt:

„Wir erklären, dass unsere Gesellschaft nach den Umständen, die uns in dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem die Rechtsgeschäfte vorgenommen und die Maßnahmen getroffen wurden, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhalten hat. Nachteile im Sinne von §312 AktG haben sich aus den Beziehungen zu verbundenen Unternehmen für uns nicht ergeben.“

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Kennzahlen der ELMOS Semiconductor AG nach HGB

in Mio. Euro oder %, soweit nicht anders angegeben	2007	2008	Veränderung
Umsatzerlöse	158,4	159,4	0,7%
Materialaufwand	68,0	69,5	2,2%
Personalaufwand	37,0	39,0	5,4%
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	13,0	13,8	6,5%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	53,0	50,7	-4,4%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5,0	-1,2	-75,6%
Jahresfehlbetrag	-5,3	-2,9	-45,3%

Umsatz- und Ertragsentwicklung

Unsere Erwartung eines schwierigen Marktumfelds in 2008 hat sich leider bestätigt. Die weltweite Konjunkturkrise, insbesondere auch im Automobilsektor, erreichte ELMOS zu Ende des dritten Quartals 2008. Der Auftragseingang ging zu diesem Zeitpunkt deutlich zurück. Grund waren Verschiebungen oder Stornierungen von Aufträgen seitens der Automobilzulieferer aufgrund des deutlich geringeren Absatzes von Neufahrzeugen. Der niedrigere Absatz betraf im Automobilsegment alle Produktgruppen. Trotz der deutlichen Verschlechterung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hat sich ELMOS besser entwickelt als viele Wettbewerber und konnte aufgrund eines guten ersten Halbjahrs einen Umsatz von 159,4 Mio. Euro im Berichtsjahr, also sogar noch leicht besser als im Vorjahr (158,4 Mio. Euro), erreichen.

Materialaufwand, Personalaufwand und Abschreibungen sind leicht überproportional zum Umsatz gestiegen. Der Anstieg des Materialaufwands ist auf höhere bezogene Leistungen von verbundenen Unternehmen zurückzuführen, die gestiegenen Personalkosten auf die höhere durchschnittliche Beschäftigung und die gewachsenen Abschreibungen auf die außerplanmäßigen Abschreibungen auf das

immaterielle Anlagevermögen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken um 4,4%. Insgesamt ergab sich ein Rückgang des Verlustes aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von -5,0 Mio. Euro in 2007 auf -1,2 Mio. Euro im Berichtsjahr. Der Jahresfehlbetrag verbesserte sich von -5,3 Mio. Euro in 2007 auf -2,9 Mio. Euro in 2008.

Finanzlage

Kennzahlen der ELMOS Semiconductor AG gemäß HGB

in Mio. Euro, soweit nicht anders angegeben	2007	2008	Veränderung
Jahresfehlbetrag	-5,3	-2,9	-45,3%
Abschreibungen / Zuschreibungen	13,0	13,8	6,5%
Veränderung von Rückstellungen und Gewinn/ Verlust aus Anlagenabgängen	1,3	5,9	Na
Zunahme / Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	1,4	-10,5	Na
Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	13,1	20,4	55,9%
Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	23,6	26,8	13,5%
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	-7,7	-23,7	Na
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	9,5	0,0	Na
Abnahme/Zunahme der Finanzmittel	25,3	3,1	-88,0%
Finanzmittel am Ende der Periode	37,1	40,2	8,2%

Der **Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit** stieg von 23,6 Mio. Euro in 2007 auf 26,8 Mio. Euro im Berichtsjahr. Dieser Anstieg ist das Resultat eines geringeren Jahresfehlbetrags sowie einer höheren Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen als in der Vergleichsperiode. Diese Effekte konnten den Anstieg der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva überkompensieren.

Der Cashbedarf für den **Cash Flow aus der Investitionstätigkeit** stieg von 7,7 Mio. Euro in 2007 auf 23,7 Mio. Euro im Berichtsjahr. Hintergrund ist v.a. das geringere Ausmaß an Vermögensgegenständen, die im Berichtsjahr in Sale-and-Lease-Back-Strukturen überführt wurden.

Der Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit zeigt keine Veränderung, so dass im Geschäftsjahr 2008 die liquiden Mittel um 3,1 Mio. Euro auf 40,2 Mio. Euro (31. Dezember 2007: 37,1 Mio. Euro) stiegen.

Vermögenslage

Kennzahlen der ELMOS Semiconductor AG gemäß HBG

in Mio. Euro, soweit nicht anders angegeben	31.12.2007	31.12.2008	Veränderung
Anlagevermögen	134,3	143,0	6,5%
Vorräte	29,7	32,8	10,4%
Forderungen und sonstige Vermögenswerte	32,4	40,8	25,9%
Flüssige Mittel	38,2	40,2	5,1%
Übrige Aktiva	5,4	5,4	-0,2%
Aktiva, gesamt	240,0	262,1	9,2%
Eigenkapital	143,9	141,0	-2,0%
Verbindlichkeiten	86,0	105,9	23,2%
Übrige Passiva	10,1	15,1	50,2%
Passiva, gesamt	240,0	262,1	9,2%

Im Vergleich zum 31. Dezember 2007 stieg die Bilanzsumme um 9,2% auf 262,1 Mio. Euro am Bilanzstichtag des Berichtsjahrs. Investitionen in das Anlagevermögen, Anstiege bei Vorräten sowie bei Forderungen und sonstigen Vermögenswerten waren die wesentlichen Ursachen für dieses Wachstum. Auf der Passivseite waren die höheren Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen der Hauptgrund für den Anstieg der Bilanzsumme. Die Eigenkapitalquote sank am Bilanzstichtag auf 53,8% (31. Dezember 2007: 60,0%).

Berichterstattung nach §289 Abs. 4 HGB zugleich erläuternder Bericht nach §120 Abs. 3 Satz 2 AktG

Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals

Das in der Bilanz zum 31. Dezember 2008 aus 19.414.205 auf den Inhaber lautenden, nennwertlosen Stückaktien bestehende Grundkapital in Höhe von 19.414.205,00 Euro ist voll eingezahlt. Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme

Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen

Stimmrechts- und Übertragungsbeschränkungen bestehen nicht.

Direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital

Die Beteiligungsverhältnisse stellen sich bis zum 31. Dezember 2008 wie folgt dar:

	Sitz/Land der Gesellschaft	Euro	%
EFH ELMOS Finanzholding GmbH	Dortmund/Deutschland	1.485.789	7,7
Makos GmbH	Dortmund/Deutschland	3.236.584	16,7
Dr. Weyer GmbH	Schwerte/Deutschland	3.236.584	16,7
ZOE-BTG GmbH	Duisburg/Deutschland	2.306.833	11,9
Streubesitz		9.148.415	47,1
		19.414.205	100,0

Die drei Gesellschaften Makos GmbH, Dr. Weyer GmbH und ZOE-BTG GmbH sind 100%ige Tochtergesellschaften der EFH ELMOS Finanzholding GmbH. Damit beträgt der direkte und indirekte Anteilsbesitz der EFH ELMOS Finanzholding GmbH an der ELMOS Semiconductor AG in Summe 52,9%.

Inhaber von Aktien mit Sonderrechten

Aktien mit Sonderrechten wurden nicht ausgegeben.

Art der Stimmrechtskontrolle im Falle von Arbeitnehmerbeteiligungen

Dieser Punkt trifft auf die Gesellschaft nicht zu.

Gesetzliche Vorschriften und Satzungsbestimmungen über die Ernennung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern und über Satzungsänderungen

Wir verweisen auf die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften für die Bestellung und Abberufung von Mitgliedern des Vorstands (§§84, 85 AktG) sowie für die Änderung der Satzung (§§133, 179 AktG). Ergänzende Bestimmungen aus der Satzung ergeben sich nicht.

Befugnisse des Vorstands zur Ausgabe und zum Rückkauf von Aktien

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 18. Mai 2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 9.650.000,00 Euro durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 9.650.000 Stück neuer, auf den Inhaber lautender Aktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen und gem. §204 AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrates über den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Ausgabe zu entscheiden (**Genehmigtes Kapital I**).

Das Grundkapital ist um 885.795,00 Euro bedingt erhöht (**Bedingtes Kapital I**). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Führungsorgane und an Mitarbeiter verbundener Unternehmen. Sie wird nur insoweit durchgeführt, wie im Rahmen des Aktienoptionsprogrammes der Gesellschaft nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 22. September 1999 Optionsrechte ausgegeben werden und die Inhaber dieser Optionsrechte diese ausüben. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Optionsrechten entstehen, am Gewinn teil.

Das Grundkapital ist um maximal bis zu 5.000.000 Euro bedingt erhöht (**Bedingtes Kapital II**). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Optionsscheinen oder Wandlungsrechten aus bis zum 09. Mai 2012 durch die Gesellschaft oder eine unmittelbare oder mittelbare inländische oder ausländische 100%-ige Beteiligungsgesellschaft der Gesellschaft gemäß der Beschlussfassung der Hauptversammlung vom 10. Mai 2007 begebenen Options- oder Wandelschuldverschreibungen Gebrauch machen oder wie die zur Wandlung verpflichteten Inhaber der von der Gesellschaft oder deren unmittelbaren oder mittelbaren inländischen oder ausländischen 100%-igen Beteiligungsgesellschaften bis zum 09. Mai 2012 auszugebenden Wandelschuldverschreibungen ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Options- bzw. Wandlungsrechten oder durch Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil.

Das Grundkapital ist um 930.000 Euro bedingt erhöht (**Bedingtes Kapital III**). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der

Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Führungsorgane und an Mitarbeiter verbundener Unternehmen („Aktienoptionsplan 2004“). Sie wird nur insoweit durchgeführt, wie im Rahmen des Aktienoptionsplans 2004 der Gesellschaft nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 27. April 2004 Optionsrechte ausgegeben werden und die Inhaber dieser Optionsrechte diese wirksam ausüben. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Optionsrechten entstehen, am Gewinn teil.

Die Gesellschaft ist ermächtigt, bis zum 07. November 2009 eigene Aktien zu erwerben. Die Ermächtigung ist auf den Erwerb von Aktien, auf die ein Anteil am Grundkapital in Höhe von bis zu insgesamt 10% des derzeitigen Grundkapitals entfällt, beschränkt. Die Ermächtigung kann ganz oder in mehreren Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, für einen oder mehrere Zwecke im Rahmen der vorgenannten Beschränkung ausgeübt werden.

Wesentliche Vereinbarungen, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels in Folge eines Übernahmeangebots stehen

Wesentliche Vereinbarungen für den Fall eines Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots existieren nicht.

Entschädigungsvereinbarungen

Auch Entschädigungsvereinbarungen bestehen nicht.

Gesamtbezüge des Vorstands

Das Aufsichtsratsplenum beschließt das Vergütungssystem und die wesentlichen Vertragselemente für den Vorstand und überprüft es regelmäßig. Die Gesamtvergütung des Vorstands umfasst ein fixes Monatsgehalt, eine Tantieme, Gratisaktien sowie Nebenleistungen und Pensionszusagen. Auf eine individualisierte Veröffentlichung der Vergütung wird zur Wahrung der Privatsphäre verzichtet. Eine solche Offenlegung trägt nach Einschätzung von Vorstand und Aufsichtsrat nicht zu einer erweiterten Transparenz in Form von zusätzlichen kapitalmarktrelevanten Informationen bei. Aus diesem Grund hat die Hauptversammlung am 19. Mai 2006 beschlossen, die Gesellschaft für einen Zeitraum von fünf Jahren von der durch das Vorstandsvergütungsoffenlegungs-Gesetz vom 3. August 2005 eingeführten Rechtspflicht zur individualisierten Offenlegung der Vorstandsvergütung zu befreien.

Im Geschäftsjahr 2008 beliefen sich die fixen Bezüge der Mitglieder des Vorstands auf 1.244 Tsd. Euro (2007: 1.655 Tsd. Euro) und die variablen Bezüge auf 525 Tsd. (2007: 185 Tsd. Euro) Euro. Die Bezüge des Vorstands teilen sich in fixe Bezüge und variable, erfolgsorientierte Bezüge auf, die sich auf Ergebnisgrößen des ELMOS-Konzerns beziehen. Im Jahr 2008 wurden wie im Vorjahr Gratisaktien der ELMOS Semiconductor AG an die Mitglieder des Vorstands ausgegeben. Der Zeitwert der Aktien betrug zum Übertragungszeitpunkt 41 Tsd. Euro (2007: 65 Tsd. Euro). Für

Mitglieder des Vorstands der ELMOS Semiconductor AG bestehen mittelbare Pensionszusagen, für die aufgrund des Umfangs der Zusage und der vollständig kongruenten Rückdeckung durch eine Rückdeckungsversicherung keine Pensionsrückstellung zu bilden ist. Im Jahr 2008 beliefen sich die Beiträge für diese Pensionspläne auf 366 Tsd. Euro (2007: 432 Tsd. Euro). Diese sind in den fixen Bezügen enthalten.

Die Bezüge für frühere Vorstandsmitglieder bzw. ihre Hinterbliebenen lagen im Geschäftsjahr 2008 bei 255 Tsd. Euro (2007: 79 Tsd. Euro). Ferner wurden für diese Versicherungsprämien in Höhe von 275 Tsd. Euro (2007: 200 Tsd. Euro) entrichtet.

Die Pensionsrückstellung zum 31. Dezember 2008 betrug 2.505 Tsd. Euro (2007: 2.536 Tsd. Euro). Abgesehen von Pensionen sind für den Fall der Beendigung der Tätigkeit keinem Vorstandsmitglied weitere Leistungen zugesagt worden. Ebenso hat kein Mitglied des Vorstands im abgelaufenen Geschäftsjahr Leistungen oder entsprechende Zusagen von einem Dritten im Hinblick auf seine Tätigkeit als Vorstandsmitglied erhalten.

Gesamtbezüge des Aufsichtsrats

Die Vergütung des Aufsichtsrats ist in §9 der Satzung festgelegt. Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben der Erstattung ihrer Auslagen eine feste und eine erfolgsorientierte Vergütung. Die erfolgsorientierte Vergütung ist an die Dividende gebunden und damit auf den langfristigen Unternehmenserfolg ausgerichtet. Dem Aufsichtsrat werden keine Aktien der ELMOS Semiconductor AG zugeteilt.

Entsprechend der Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex hinsichtlich der Berücksichtigung des Vorsitzes und stellvertretenden Vorsitzes bei der Vergütung erhält der Vorsitzende das Doppelte und sein Stellvertreter das Eineinhalbfache der festen Vergütung. Der Vorsitz und die Mitgliedschaft in Aufsichtsratsausschüssen werden nicht gesondert vergütet. Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wird summiert, jedoch nicht individualisiert ausgewiesen. Dies gilt auch für an Mitglieder des Aufsichtsrats gezahlte Vergütungen für persönlich erbrachte Leistungen, insbesondere für Beratungs- und Vermittlungsleistungen.

Die feste Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats betrug im Geschäftsjahr 2008 in der Summe 82 Tsd. Euro (2007: 92 Tsd. Euro). Spesen und Auslagen sind darin enthalten. Da in 2008 keine Dividende an die Aktionäre ausgezahlt wurde, ist an die Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2008 keine variable Vergütung gezahlt worden. Für Beratungen, Erfindervergütungen und sonstige Dienstleistungen vergütete die Gesellschaft an Mitglieder des Aufsichtsrats 342 Tsd. Euro (2007: 377 Tsd. Euro).

Risiko- und Chancenbericht

Risiko- und Chancenmanagementsystem

ELMOS betreibt ein ganzheitliches Risiko- und Chancenmanagementsystem zur konsequenten Nutzung ihrer Chancen, ohne die damit verbundenen Risiken außer Acht zu lassen. Risiken und Chancen werden regelmäßig analysiert. Die ELMOS Semiconductor AG fasst die innerhalb des Unternehmens vorhandenen Maßnahmen zur Risikosteuerung in einem einheitlichen und durchgängigen Risikomanagementsystem zusammen. Das System entspricht den gesetzlichen Anforderungen an ein Risikofrüherkennungssystem und steht im Einklang mit den Deutschen Corporate Governance Grundsätzen.

Risiken

Abhängigkeit von der Automobilindustrie

Das Kerngeschäft von ELMOS steht in direktem Zusammenhang mit der Nachfrage der Automobilindustrie nach Halbleitern. Nach wie vor werden rund 90% des Umsatzes mit Chips für die Automobilelektronik erwirtschaftet. Diese Nachfrage ist einerseits abhängig von den produzierten Stückzahlen an Fahrzeugen und wird andererseits von dem anhaltenden Trend zu mehr Elektronik im Auto gesteuert. Der starke Einbruch bei den Automobil-Produktions- und Absatzzahlen, welcher seit Herbst 2008 zu verzeichnen ist, stellt auch für ELMOS als Halbleiterlieferanten ein Risiko dar. Gegen diese Entwicklung steuert ELMOS mit entsprechenden Kostensenkungsmaßnahmen entgegen; jedoch dürfte ein anhaltender Nachfragerückgang aus der Automobilindustrie signifikante Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben.

Der Automobilmarkt unterlag in der Vergangenheit als Folge von Zusammenschlüssen von Systemherstellern, restriktiver Umweltgesetzgebung und anderen Faktoren beachtlichen Schwankungen. Die Kundenstruktur deutet auf eine gewisse Abhängigkeit von einigen großen Automobilzulieferern hin. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass ein Kunde in der Regel mehrere Produkte mit verschiedenen Lebenszyklen bezieht. Aufgrund der Tatsache, dass ASICs kundenspezifische Produkte sind, ergibt sich eine besondere gegenseitige Abhängigkeit zwischen Lieferant und Kunde. Abweichend davon kann es bei großen Stückzahlen der Fall sein, dass ein Kunde bei zwei Lieferanten einen ASIC entwickeln lässt. Durch die verstärkte Hinwendung von ELMOS zu anwendungsspezifischen Standardprodukten (ASSPs) wird diese Kundenabhängigkeit verringert, da solche Produkte an mehrere Kunden verkauft werden können.

Wettbewerb

Eine Vielzahl von Wettbewerbern im Halbleitermarkt für automobiler Anwendungen bietet ähnliche Produkte wie ELMOS auf vergleichbarer technologischer Grundlage an. Darüber hinaus ist nicht auszuschließen, dass große Halbleiterhersteller, die bisher noch gar nicht oder nur zu einem geringen Prozentsatz im automobilen Halbleitermarkt tätig sind, in Zukunft versuchen werden, in dieses Marktsegment einzudringen. Die Wahrscheinlichkeit für deren Engagement in einem solchen Nischenmarkt ist jedoch relativ gering und somit auch das für ELMOS damit verbundene Risiko. Bei großvolumigen Aufträgen steht ELMOS allerdings mehr im Wettbewerb auch zu Großproduzenten und spürt entsprechenden Preisdruck. Zudem besteht für ELMOS das Risiko, dass Kunden auf Wettbewerber zurückgreifen, wenn Parallelentwicklungen durchgeführt werden.

Abhängigkeit von einzelnen Mitarbeitern

Die sehr entwicklungsintensive Geschäftstätigkeit des Unternehmens führt zu einem stark ausgeprägten und sehr spezifischen Ingenieur-Know-how – jedoch nur teilweise zu Patenten. Somit ergibt sich für ELMOS, wie für jedes Technologieunternehmen, eine erhöhte Abhängigkeit von bestimmten Mitarbeitern.

Entwicklung neuer Produkte und Technologien

Bei der kundenspezifischen Entwicklung von Produkten werden heute in der Regel die Einmalkosten im Entwicklungsbereich nicht mehr in vollem Umfang von den Kunden bezahlt. Diese vorab nicht gedeckten Entwicklungskosten müssen über die späteren Stückzahlen in der Serie amortisiert werden. Bei Entwicklungen, die nicht in eine Lieferbeziehung münden, besteht das Risiko, dass nicht amortisierte Kosten bei der Gesellschaft verbleiben. Gerade bei den hochvolumigen Aufträgen, um die sich eine größere Anzahl von Wettbewerbern bemüht, ist der Kunde in der Regel nicht bereit, die Entwicklungskosten vorab zu übernehmen, sondern erwartet, dass diese vom Lieferanten vorfinanziert werden. Für von ELMOS selbst initiierte Produktentwicklungen, wie beispielsweise alle ASSPs, ist dies in der Regel der Fall, da hierfür keine festen Kundenaufträge vorliegen.

Der Markt für die ELMOS-Produkte ist durch ständige Weiterentwicklung und Verbesserung der Produkte gekennzeichnet. Der Erfolg von ELMOS ist deshalb stark von der Fähigkeit abhängig, neue komplexe Produkte preisgünstig zu entwickeln, sie rechtzeitig im Markt einzuführen und zu erreichen, dass diese Produkte von führenden Zulieferern der Automobilindustrie ausgewählt werden.

Durch die Fähigkeit von ELMOS, Produkte für alle Arten von elektronischen Geräten im Automobil zu entwickeln und zu fertigen, sind ELMOS-Produkte in zahlreichen elektronischen Komponenten eines PKWs vertreten, so dass

das Risiko des Wegfalls eines Auftrages für eine einzelne elektronische Komponente breit gestreut ist.

Der zukünftige Erfolg von ELMOS ist auch von der Fähigkeit abhängig, neue Entwicklungs- und Produktionstechnologien zu entwickeln. ELMOS entwickelt analoge und digitale Halbleiterstrukturen und -funktionen für ihre selbst entwickelte modulare Hochvolt-CMOS-Prozesstechnologie. Wie alle Wettbewerber muss auch ELMOS ihre Technologie ständig verbessern und neue Prozesstechnologien für die fortschreitende Verkleinerung der Strukturen im Submikronbereich entwickeln. Sollte ELMOS zukünftig nicht in der Lage sein, neue Produkte und Produktverbesserungen zu entwickeln, zu produzieren und abzusetzen, dürfte dies signifikante Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben.

Beschaffung

Die von ELMOS für die Fertigung benötigten Rohstoffe sind weltweit bei verschiedenen Lieferanten verfügbar und unterliegen weitestgehend keinen Monopolanbietern. Branchentypisch ist eine gewisse Abhängigkeit von einzelnen fernöstlichen Partnern im Assembly-Bereich. ELMOS hat das Risiko gestreut, indem mit mehreren Partnern zusammengearbeitet wird.

Produkthaftung

Die von ELMOS produzierten Produkte werden als Komponenten in komplexe elektronische Systeme integriert. Fehler oder Funktionsmängel der von ELMOS hergestellten Halbleiter oder der elektronischen Systeme, in die sie integriert sind, können direkt oder indirekt Eigentum, Gesundheit oder Leben Dritter beeinträchtigen. ELMOS ist nicht in der Lage, ihre Haftung gegenüber Abnehmern oder Dritten in ihren Absatzverträgen zu reduzieren oder auszuschließen.

ELMOS verfolgt konsequent eine Null-Fehler-Strategie und investiert stetig in die Erkennung und Vermeidung von Fehlerquellen und Fehlern. So werden die einzelnen Halbleiterchips hinsichtlich ihrer Qualität und Funktion in der Produktion im Regelfall mehrfach bei unterschiedlichen Temperaturen getestet. Obwohl die Gesellschaft weitreichende Testverfahren vor der Auslieferung ihrer Produkte einsetzt, können sich Produktfehler möglicherweise erst beim Verbau oder dem Gebrauch der Produkte durch den Endverbraucher zeigen.

Wenn solche Produktfehler auftreten, kann dies teure und zeitaufwendige Produktmodifikationen nach sich ziehen und zu Beeinträchtigungen in den Kundenbeziehungen sowie zum Verlust von Marktanteilen führen. Ein Qualitätsproblem ganzer Chargen könnte zudem zu Regressansprüchen der Kunden im Millionenbereich führen. Dieses Risiko ist angemessen versichert. Dennoch können diese Risiken negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben.

Beteiligungsbereich

Durch die hohe Allokation von finanziellen Mitteln in die Tochtergesellschaften besteht die erhöhte Pflicht, mit entsprechenden Controlling-Instrumenten und kontinuierlichen Soll-Ist-Analysen mögliche Risiken frühzeitig zu erkennen bzw. zu minimieren. Hierfür wird das installierte Überwachungs- und Risikomanagementsystem laufend erweitert und verbessert. Dennoch können diese Risiken negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben.

Betriebsunterbrechung

Neben den bereits dargestellten und erläuterten Geschäftsrisiken ist nach Einschätzung von ELMOS das einzige wesentliche betriebliche Risiko, das die Entwicklung des Konzerns beeinträchtigen und den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnte, das Risiko der Zerstörung der Fertigungsanlagen durch Feuer oder andere Katastrophen. Zwar ist das Betriebsunterbrechungsrisiko durch solche Ereignisse angemessen versichert, jedoch bestünde in einem solchen Fall eine erhebliche Gefahr des Verlustes von Schlüsselkunden. Dieses Risiko ist nicht versicherbar.

Dieses Risiko ist dadurch bereits reduziert, dass seit 2006 eine weitere Fertigungslinie (200mm-Linie) am Standort Duisburg betrieben wird. Zu einem späteren Zeitpunkt kann auch am Standort Dortmund in einem separaten Gebäude eine weitere Produktionslinie errichtet werden. Damit verfügt ELMOS über mehrere unabhängige Fertigungslinien, die autark produzieren können. Unabhängig davon könnte eine Betriebsunterbrechung an einem der Produktionsstandorte negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben.

Die üblichen versicherbaren Risiken wie Feuer, Feuerbetriebsunterbrechung, Wasser, Sturm, Diebstahl, Haftpflicht, insbesondere Produkthaftpflicht, auch in den USA, sowie die Kosten eines etwaigen Rückrufs, sind angemessen versichert. Weitere Risiken, die die Entwicklung des Konzerns wesentlich beeinträchtigen oder den Fortbestand des Konzerns gefährden können, sind derzeit nicht erkennbar.

Chancen

Neben unserem Kerngeschäft, der kundenspezifischen Halbleiter in der Automobilindustrie, bieten sich durch die weitere Umsetzung unsere Strategie Chancen für die Gesellschaft. Diese liegen in der vermehrten Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von applikationsspezifischen Halbleitern (ASSPs) sowie in einem zukünftig höheren Anteil unseres Umsatzes in den Bereichen Industrie und Konsumgüter, was implizit auch eine verminderte Abhängigkeit von der Automobilindustrie zur Folge hat. Zudem planen wir zukünftig, unser Geschäft in den asiatischen Märkten auszuweiten und mit Partnern zu kooperieren, die uns entweder

ermöglichen, unser Produktportfolio zu erweitern, oder Möglichkeiten zur Fremdfertigung bieten. Des Weiteren soll der Anteil an Mikrosystem-Projekten, der Zusammenführung von Sensoren und Auswerteelektronik in einem applikationsspezifischen Gehäuse, steigen.

Nachtragsbericht

Es sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung zu berichten.

Prognosebericht

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind geprägt von großer Unsicherheit und Zurückhaltung der Konsumenten, insbesondere beim Neuwagenkauf. Die Erwartungen der Marktteilnehmer und Marktforschungsinstitute für die Entwicklung des Automobilmarkts in 2009 zeigen eine extrem große Spannweite. Dies ist ein Indiz für die im Markt herrschende hohe Unsicherheit. Die Prognosen reichen von einem Rückgang der weltweiten Zulassungszahlen um 8% bis zu einem Rückgang von 25%. Bei den automobilen Zulieferern geht man für die ersten Monate 2009 zum Teil noch von deutlich stärkeren Absatzverlusten aus. Dies wird auf eine Reduktion der Lagerbestände in der Zulieferkette zurückgeführt.

Die aktuelle Lage stellt eine Sondersituation ohne Beispiel in der Geschichte der Automobilindustrie dar. Langfristig wird jedoch weiter erwartet, dass der Elektronikanteil im Automobil stetig steigt. Dabei spielt nach wie vor der anhaltende Wachstumstrend der Elektronik im Automobil eine größere Rolle als eine im normalen Bereich liegende Veränderung der Produktionszahlen in der Automobilindustrie.

Ausblick der ELMOS Semiconductor AG

ELMOS hat in den vergangenen Jahren in die Entwicklung neuer Produkte und Märkte investiert. Wir sind der Überzeugung, dass sich diese Investitionen langfristig auszahlen werden. Auch in 2009 wird ELMOS die Umsetzung der strategischen Eckpfeiler weiter vorantreiben:

- Vermehrte Definition, Entwicklung und Vertrieb von ASSPs
- Steigerung der Aktivitäten in Industrie- und Konsumgütermärkten
- Ausweitung des Engagements in den asiatischen Märkten
- Verstärkte Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern zur Optimierung des Produktportfolios und Reduktion der Investitionen
- Steigerung des Umsatzanteils von Mikrosystemen

Für das Jahr 2009 kann ELMOS aufgrund der gegenwärtig schwierigen Marktsituation und der unzureichenden Visibilität noch keine quantitative Prognose abgeben. Das erste Halbjahr 2009 wird einen deutlichen Einbruch des Umsatzes zeigen, was durch den starken Rückgang des Auftragseingangs insbesondere im letzten Quartal 2008 bedingt ist. Für den weiteren Verlauf des Jahres 2009 und darüber hinaus kann aufgrund der derzeitigen geringen Visibilität keine Aussage getroffen werden.

In 2009 wird es die Herausforderung sein, den Spagat zwischen einerseits der Entwicklung neuer Produkte und Technologiegenerationen sowie dem Zugewinn von Marktanteilen und andererseits dem Erhalt einer starken finanziellen Basis zu meistern. So ist die primäre Aufgabe in 2009 die Bewahrung einer soliden Position des Unternehmens, um die aktuell schwierige Marktlage gut zu überstehen. Finanzielle Belastungen, denen

vor dem Hintergrund der derzeitig schwachen Marktsituation nicht entsprechende Erträge gegenüber stehen, werden – so weit als möglich – reduziert.

ELMOS hat bereits seit Herbst 2008 zahlreiche Kosteneinsparmaßnahmen eingeleitet, um den im Vergleich zu den ursprünglichen Planungen ausfallenden Umsatz und damit die fehlende Fixkostendeckung zu kompensieren. Zu den Maßnahmen zählen u.a.:

- Reduktion der Einsteuerung des Wafermaterials in den Produktionsprozess zur Anpassung an den geringeren Bedarf
- Reduktion und Verschiebung von Investitionen
- Überprüfung aller Kostenpositionen im Hinblick auf ihre absolute Notwendigkeit
- Einführung von Kurzarbeit am Standort Dortmund und weiteren Standorten (ab Januar 2009)
- Verzögerung der Fertigungsumstellung am Standort Dortmund von 6- auf 8-Zoll-Wafer
- Überprüfung aller Unternehmensbereiche auf operative Verbesserungspotenziale

Das ELMOS-Management arbeitet in diesen Krisenzeiten beständig auch an Alternativszenarien, so dass, sollte sich die Notwendigkeit zusätzlicher Maßnahmen ergeben, sofort gehandelt werden kann. Gleiches gilt für den Fall einer sich abzeichnenden konjunkturellen Erholung. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit den eingeleiteten Maßnahmen, den Einsparungen und der Vorbereitung entsprechender Handlungsoptionen gut gerüstet sind. Die Kombination aus Kostenkontrolle und angepasster Umsetzung strategischer Schritte wird es uns ermöglichen, gestärkt aus der Krise hervorzugehen.

Dortmund, im März 2009

Der Vorstand



Dr. Anton Mindl



Nicolaus Graf von Luckner



Reinhard Senf

Jürgen Höllisch